



广州方邦电子股份有限公司

关于广州方邦电子股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市的科创板上
市委会议意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



二〇一九年六月

上海证券交易所：

根据贵所出具的《关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函》（以下简称“意见落实函”）的要求，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦电子”、“发行人”或“公司”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”或“保荐人”）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

本回复中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外，与其在招股说明书（注册稿）中的含义相同。

本回复的字体说明：

意见落实函所列问题	黑体、加粗
对问题的回答	宋体
对招股说明书的修改及引用	楷体、加粗
保荐机构核查意见	宋体、加粗

目 录

问题 1：请发行人补充披露研发立项和专利申请的内部制度安排。4

问题 2：请发行人补充披露募投项目挠性覆铜板的竞争对手状况和市场前景。 5

问题 1：请发行人补充披露研发立项和专利申请的内部制度安排。

回复：

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人技术与研发情况”中补充披露如下：

“（六）研发立项和专利申请的内部制度安排

为巩固和增强发行人的技术创新能力，加速发行人新技术的研发及推广应用，促进发行人经济效益的提升，发行人制定了《研发立项管理制度》等制度，根据该等制度规定，有关发行人研发立项的相关安排如下：

（1）研发部与市场部结合公司生产经营需要，通过市场评估、产品检验能力评估和技术发展方向等，提出研发项目建议；

（2）提出项目建议后，研发部将按照公司立项流程进行具体研发项目的立项工作，明确项目的名称、项目负责及参与人员、项目的实施进度计划、项目所需经费等，形成新技术研发项目方案；

（3）提出项目方案后，研发项目负责人将组织制造部和财务部等有关部门对项目方案进行审查论证，经充分论证并提出具体研发、工艺及预算计划，并报研发部负责人和公司总经理审批后实施。

同时，为保护发行人的技术研发成果，形成企业自主知识产权，推动生产技术进步，提高发行人市场竞争力和经济效益，根据《研发立项管理制度》等制度的规定，针对技术研发成果，凡是预计符合专利授予条件的，发行人将及时申请专利，以取得法律的保护。有关发行人专利申请的相关安排如下：

（1）研发项目完成后，凡需申请专利的，研发项目负责人应及时论证申请专利的必要性和可行性，对可申请专利的研发项目及时办理申请事项，准备好申请专利的所需资料并填写《专利申请审核意见表》，交由研发部负责人和总经理审批；对不宜申请专利的技术秘密，应采取相应保密措施；

（2）专利申请经审批后由公司知识产权事务负责人进行专利申请，公司也可以委托专利申请代理机构进行代理申请；

(3) 在专利申请过程中, 知识产权事务负责人将及时向研发部负责人及总经理通报专利申请工作的进展情况。”

问题 2: 请发行人补充披露募投项目挠性覆铜板的竞争对手状况和市场前景。

回复:

发行人已在招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、本次募集资金运用的具体情况”之“(一) 扰性覆铜板生产基地建设项目”中补充披露如下:

“5、挠性覆铜板的竞争对手状况和市场前景

(1) 挠性覆铜板的竞争对手状况

目前, 挠性覆铜板的生产商主要为境外企业, 发行人通过实施挠性覆铜板生产基地建设项目, 可进一步拓宽发行人的产品线, 继续保持发行人在全球高端电子材料领域的国际竞争力, 进而提高我国的挠性覆铜板进口替代率。

根据日本矢野经济研究所株式会社发布的《全球挠性覆铜板 (FCCL) 行业及重点企业现况的调查报告》, 全球主要挠性覆铜板生产商有新日铁住金化学株式会社、宇部兴产株式会社、有泽制作所株式会社、SK Innovation Co., LTD.、LS 电线公司、台虹科技股份有限公司、新扬科技股份有限公司等。上述企业的基本情况如下:

①新日铁住金化学株式会社

新日铁住金化学株式会社 (新日铁住金株式会社 (5401.T) 子公司) 成立于 1949 年, 位于日本东京市千代田区 101-0021, 主营业务为制造和销售煤化工、石化和电子材料。新日铁住金化学是世界上最大的无胶软板基材生产厂家, 由无粘结剂聚酰亚胺的覆铜箔层压板与相关材料所生产的 [ESPANEX] 系统的系列化, 可以实现高性能的全聚酰亚胺挠性印制电路板。此外, 为对应印刷线路板的高密度、高速度、低价格等市场需求, 新日铁住金化学在电子材料方面不断革新、并不断推出新型材料。2017 财年新日铁住金株式会社的化学业务分部收入为 2,007.67 亿日元, 2018 财年化学和材料业务分部收入为 2,470.67 亿日元。

②宇部兴产株式会社 (4208.T)

宇部兴产株式会社（4208.T）成立于1897年，位于日本宇部市山口县，注册资本为584亿日元，主要包括化学医药、建筑材料、机械三大业务，2018财年收入为7,301亿日元。

③有泽制作所株式会社

有泽制作所株式会社（Arisawa Mfg.Co., Ltd）成立于1949年7月1日，是日本上市公司（5208.T），注册地为日本新潟县上越市南本町一丁目5番5号，主营业务包括制造和销售电子材料、光电材料、电绝缘材料和工业结构材料等。2018财年营业收入为447亿日元。

④SK Innovation Co.,LTD.

SK Innovation Co.,LTD. 成立于1962年，总部位于首尔特别市钟路区26, SK大厦。其前身为韩国首家炼油、化工企业——大韩石油，目前主要业务包括石油开发、炼油、化学、润滑油及未来能源产业。公司与韩国TORAY ADVANCED MATERIALS KOERA Inc.（东丽尖端材料株式会社）开展密切合作，在业界中率先开发出新产品并在抢先开拓市场方面取得好的促进作用。

⑤LS 电线公司

LSMTRON公司（LS电线公司）近年在双面溅射-电镀法2L-FCCL开发与销售上，有了更多的投入。上述工作开展，具体表现在：加强了提供用户设计的式样方面的工作，使得实现了基材性能对应更为准确。并且还在设备配备上，进行了改造、添置，使得对FPC的设计、工艺，能够更为齐全，以便客户看样，能够更及时、方便。

⑥台虹科技股份有限公司

台虹科技股份有限公司成立于1997年，是台湾上市公司（8039.TW），注册地为高雄市前镇区高雄加工出口区环区三路一号，主营业务包括高分子薄膜铜箔基层板，保护胶片，太阳能模组用背板。公司拥有自主性基础配方和涂布两大核心技术优势，成为软性铜箔基层板及太阳能电池模组背板供应商，目前软性铜箔基层板全球市占率约20%，大中华区市占率第一，2018年营业收入为96.43亿元新台币。

⑦新扬科技股份有限公司

新扬科技股份有限公司成立于2000年，是台湾上柜公司（3144.TWO），注

册地为高雄市路竹区路科二路8号，注册资本为20亿元新台币，凭借强大的研发团队以及多项自我创新及研发的技术，专业制造各系列聚酰亚胺软性铜箔基材及相关材料。2018年营业收入为26.17亿元新台币。

(2) 挠性覆铜板的市场前景

挠性覆铜板是FPC的重要原材料之一，随着智能手机、电脑、可穿戴设备、汽车电子等现代电子产品的发展，FPC产值整体呈上升趋势。根据Prismark的统计，2017年全球FPC产值为125.2亿美元，同比增长14.9%。消费电子产品、汽车电子产品、通信设备是FPC三大应用领域，其轻薄化趋势日益显现，可以预见，未来FPC的市场需求将维持一定的增长速度。

近年来，受全球PCB及FPC产业转移影响，中国FPC产值持续保持高速增长，中国逐渐成为FPC主要产地，中国FPC产值占全球的比重不断提升。据Prismark的数据，2016年中国FPC行业产值达到46.3亿美元，中国FPC（含外资企业）产值占全球的比重从2009年23.7%已增至2016年42.5%。带动FPC产品的主要原材料挠性覆铜板市场进一步向中国集中。根据新思界产业研究中心发布的《2018-2022年中国挠性覆铜板产品市场分析可行性研究报告》显示，2017年中国挠性覆铜板产量为6,010万平方米，同比增长10%；销量为5,949万平方米，同比增长9.42%；销售额为26.94亿元，同比增长5.35%。中国挠性覆铜板市场规模不断扩大。同时，随着国产挠性覆铜板产品技术含量不断提高，国内挠性覆铜板市场规模及进口替代率有望进一步突破，发行人的挠性覆铜板项目具有良好的市场前景。”

(本页无正文，为广州方邦电子股份有限公司《关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函的回复》之盖章页)



(本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委员会意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人: 袁琳翁

袁琳翁

张冠峰

张冠峰

华泰联合证券有限责任公司



2019年6月21日

声明

本人已认真阅读广州方邦电子股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函回复的全部内容，了解意见落实函回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，意见落实函回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：_____



江 禹

华泰联合证券有限责任公司

2019年 6 月 21 日

